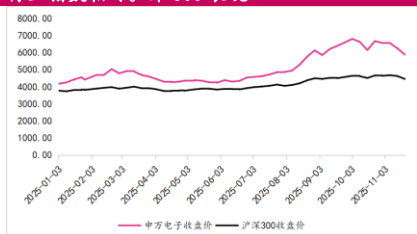


电子行业

2025 年 11 月 23 日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
腾景科技	152.00	34.50	196.61
赛微电子	33.49	28.71	245.22
久之洋	48.60	23.60	87.48
大为股份	32.98	16.87	78.31
爱克股份	25.80	14.16	56.82
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
香农芯创	126.41	-27.60	587.66
显盈科技	34.40	-23.08	33.45
阿石创	33.00	-20.96	50.56
普冉股份	121.97	-18.69	180.58
佰维存储	103.66	-18.43	483.79

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

【金元电子】周报 20251012 AMD 与 OPENAI 达成 6GW 协议，开发互连技术 UALink 或加速渗透

【金元电子】周报 20251019 英伟达发布 800VDC 白皮书，“功率墙”应予以重视

【金元电子】周报 20251026 谷歌将量子优势的概念从随机任务推进到可重复验证、具备应用潜力的新阶段

【金元电子】周报 20251109 寒武纪优化基础软件平台，或加速国产算力落地

【金元电子】周报 20251117 中芯国际三季度产品结构、产能利用率改善，毛利率超预期

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

—谷歌推出 Gemini 3 Pro，推理、多模态、长上下文能力提升

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数下跌3.90%，深证成指下跌5.13%，沪深300指数下跌3.77%，申万电子板块下降5.89%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为21/31。板块个股涨幅前五名分别为：腾景科技、赛微电子、久之洋、大为股份、爱克股份；跌幅前五名分别为：香农芯创、显盈科技、阿石创、普冉股份、佰维存储。
- **电子行业：**电子行业呈现普跌且跌幅分化显著的格局。从申万二级行业数据看，各子板块均录得下跌，其中其他电子II板块本周下跌11.95%，为本周表现最弱的方向；其下申万三级行业其他电子III同样下跌11.95%，走势完全一致。半导体板块整体下跌6.09%，内部结构差异较大，半导体设备子板块下跌7.19%，模拟芯片设计下跌6.76%，半导体材料下跌7.08%，多个细分领域拖累板块表现。消费电子板块下跌5.62%，延续调整态势，消费电子零部件及组装下跌5.79%对板块形成主要拖累，品牌消费电子下跌3.71%。元件板块下跌5.36%，细分领域中印制电路板下跌5.50%，被动元件下跌4.71%，表现承压。光学光电子板块下跌4.96%，LED下跌5.85%，面板下跌5.90%，光学元件下跌2.20%，板块整体显弱势。电子化学品II板块下跌3.71%，电子化学品III子板块同幅下跌3.71%。总体来看，本周电子行业全板块下跌且分化明显，其他电子II领跌，半导体、消费电子、元件等多个细分领域承压，行业呈现整体性调整且内部跌幅差异较大的态势。
- **行业要闻**
 - ◆ 谷歌发布最新大模型Gemini 3/ Gemini 3 Pro，推理性能提升
 - ◆ 三星将记忆体价格涨幅提高至六成，大型AI资料库建设压力增加
 - ◆ 英特尔Granite Rapids-WS曝光，Intel 3制程、最高128核登场
 - ◆ 安谋携手辉达NVLink，抢占AI伺服器CPU市场
 - ◆ 记忆体短缺恶化，AMD、辉达传缩减游戏显卡产能
 - ◆ 辉达续与鸿海伟创艾克尔矽品合作，四年内扩大美国布局
 - ◆ 放行中东采购，美允许G42、Humain各自可获3.5万颗AI晶片
- **公司动态：**
 - ◆ 洲明科技：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
 - ◆ 普冉股份：关于收购珠海诺亚天存储技术有限公司股权的公告
 - ◆ 好利科技：2025年第五次临时股东大会决议公告
 - ◆ 深圳华强：2025年第三季度权益分派实施公告
 - ◆ 沪电股份：关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告
- **投资建议：** 我们认为，Gemini 3.0 Pro 并不是简单的参数量升级，而是围绕高性能推理+多模态应用展开的一次系统性范式跃迁。在模型层面，基于稀疏 MoE 架构、自动模型选择与 Deep Think 增强推理，实现了在长上下文、多模态理解与复杂推理任务上的 SOTA 表现，并显著优化性能/成本比；在系统与算力层面，则依托 TPU v6/v7（Ironwood）上的第三代 Sparse Core、OCS 光路交换网络以及 HBM4 与全局共享显存架构，解决了大模型在稀疏激活、超大规模训练与“无限上下文”推理中的算力利用率与内存瓶颈问题。综合来看，Gemini 3.0 Pro 代表的是从“训练优先、单一模态”向“推理优先、多模态、长上下文”的基础设施升级，与此同时，硬件需求或转向从强调通用计算的 GPU 至推理及应用的 ASIC 市场，集群连接则进一步强调全光方案。相关公司包括：1、ASIC 及推理芯片：寒武纪-U、瑞芯微、云天励飞等；2、OCS 及组件：光库科技、三环集团、赛微电子等
- **风险提示：** 1、AI 需求不及预期：AI 基础设施投入较大，需求落地不及预期，导致资产回报率较低；2、产业竞争格局风险：随着以 Google、ChatGPT 为首的 AI 大模型占据市场，或导致市场份额逐渐集中；3、技术风险：当前 AI 硬件、架构更新迭代频繁，或导致相关领域替代风险。

目录

一、核心观点3

二、行业跟踪8

三、行业新闻11

四、公司公告17

五、下周重要事件提示23

图表目录

图 1: Gemini 3.0 Pro 支持多模态3

图 2: Gemini 3.0 Pro 多项性能领先4

图 3: Gemini 3 动态创建交互式可视化模型4

图 4: Ironwood 架构图5

图 5: 本周各行业版块涨跌幅8

图 6: 本周电子版块：子版块涨跌幅9

图 7: 电子板块历史走势10

图 8: 电子板块历史市盈率10

表 1: 本周电子板块个股涨幅前五名8

表 2: 本周电子版块个股跌幅前五名8

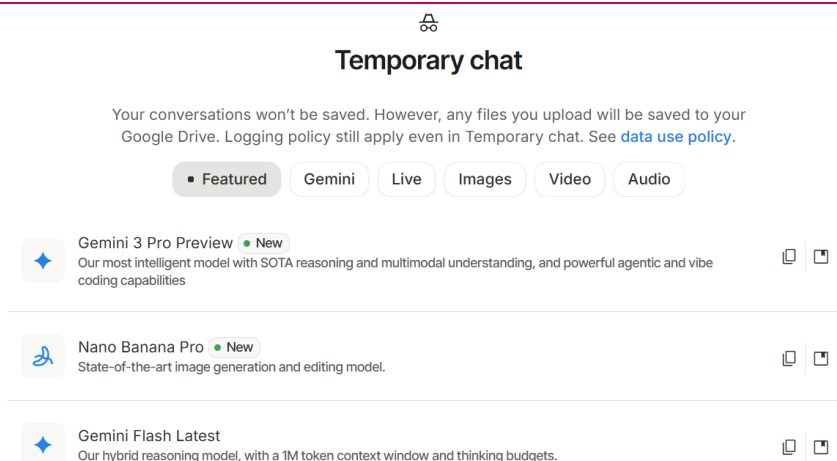
表 3: 下周重要会议23

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）24

一、核心观点

谷歌发布最新一代 AI 大模型 Gemini 3.0 及 Gemini 3.0 Pro，被称为“迄今最智能的模型”，在推理、多模态等方面均取得了较大进步。Gemini 3 Pro 在应用场景上扩展至文字、图片、音频、视频以及代码等多种数据类型。长上下文处理能力也大幅提升，能够拥有高达百万 Token 的上下文窗口，可以一次性读入复杂学术论文、长视频等。

图 1：Gemini 3.0 Pro 支持多模态

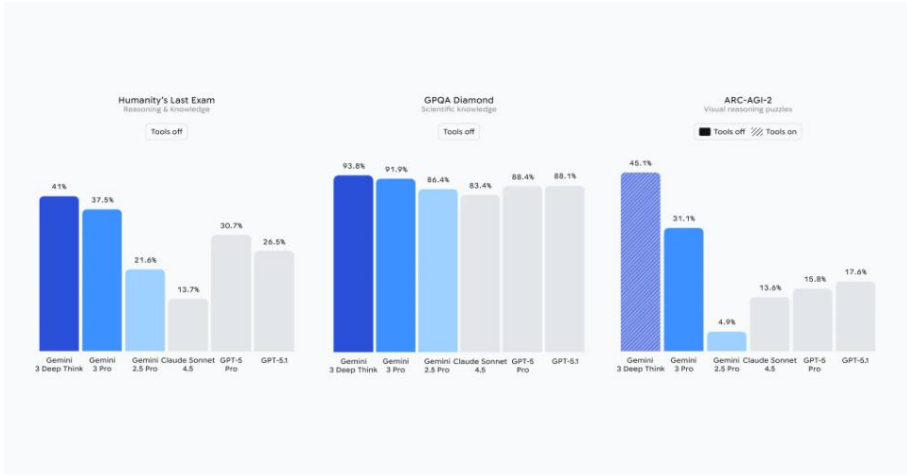


数据来源：Google，金元证券研究所

Gemini 系列自第一代起就强调多模态能力（支持图像、文本等）。在效率方面，Gemini 3 Pro 通过架构和推理模式实现了卓越的性能/成本比提升。一方面，稀疏 MoE 架构使模型拥有非常高的参数总量但推理时仅激活部分专家网络，大幅降低计算开销。另一方面，Google 引入了自动模型选择机制，针对简单查询由小模型快速回答，复杂任务才由 Gemini 3 接管，从而实现“效率与智能兼备”。这种设计在实际部署中既能发挥大模型的威力，又能控制成本和响应速度。此外，Gemini 3 推出了 Deep Think 增强推理模式，用于最棘手的问题求解。Deep Think 模式通过更长的推理链和工具使用，将 Gemini 3 的推理与多模态理解能力进一步提升一个台阶，在需要逐步规划和创新思路的任务上，比普通 Pro 模式性能再提高约 10%-20%。

在专业评测中，Gemini 3 Pro 以 81% 的成绩刷新了多模态理解基准 MMMU-Pro 记录，在视频多模态推理基准 Video-MMMU 上也达 87.6%，均创当前最新的 SOTA (state-of-the-art) 纪录，领先竞争对手 GPT-5.1 和 Claude 4.5。例如，在复杂截图理解任务 ScreenSpot-Pro 中，Gemini 3 Pro 准确率高达 72.7%，而其他旗舰模型仅约 36.2%，实现了一倍以上的性能提升，表现出在视觉信息理解和推理上建立了显著优势，可准确分析图像内容并进行逻辑推断。

图 2: Gemini 3.0 Pro 多项性能领先



数据来源: Google, 金元证券研究所

除理解能力以外，Gemini 3 还具备强大的生成与交互能力。它能够根据用户提示自动生成交互式可视化和多媒体内容，例如，在搜索中用户询问复杂物理问题时，Gemini 3 能动态创建交互式可视化模型。在官方演示中，仅用一句话就生成了可玩的 3D 小游戏和科普动画，实现了一句话生成 3D 世界。

图 3: Gemini 3 动态创建交互式可视化模型



数据来源: Google DeepMind, 金元证券研究所

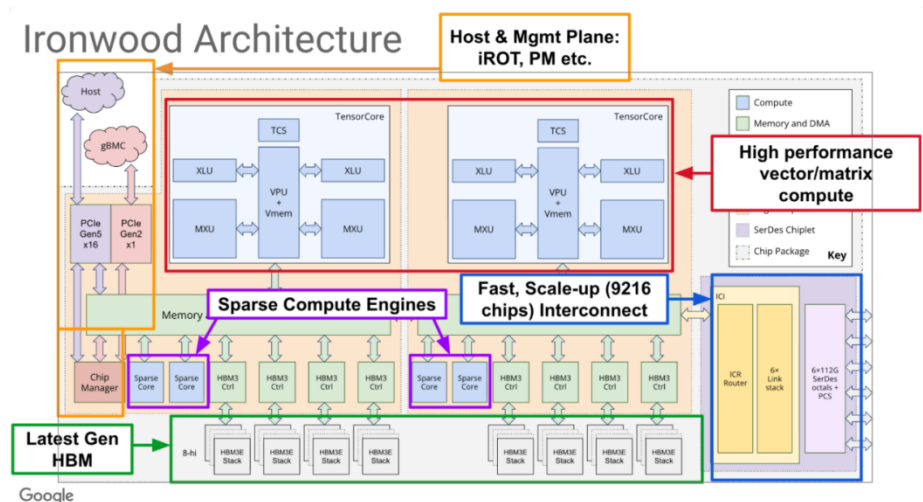
此外，Gemini 3 内置了高水平的代码理解和生成能力。它可以产出高保真的代码来进行数据可视化或游戏开发，并在编码助理 Benchmark（如 LiveCodeBench、SWE-Bench 等）上成绩接近甚至持平 GPT-5.1 等最强对手。总体而言，Gemini 3 Pro 集成了多模态感知（读图、读视频能力）与多技能生成（文本、代码、图像生成）的能力，让模型能够跨越文本与视觉、分析与创作的界限。

Gemini 3 Pro 的训练与推理主要依托于谷歌第六代 TPU（代号 Trillium）的成熟集群以及最新部署的第七代 TPU（代号 Ironwood）。这种硬件架构并非简单的算力堆砌，而是针对万亿参数级 MoE（混合专家模型）和超长上下文（Infinite Context）进行了极其深入的软硬协同设计。

Gemini 3 Pro 的核心计算引擎经历了从通用 AI 加速向“推理优先（Inference-First）”架构的根本性转变。在 Gemini 3 Pro 的训练后期及大规模部署阶段，谷歌主要启用了第七代 TPU Ironwood。与前代 Trillium 相比，Ironwood 最大的改进在于其针对稀疏计算的专用优化。Gemini 3 Pro 采用的是高度动态的 MoE 架构，这意味着在任何一次推理中，只有极少部分的参数被激活。传统的密集计算单元（如 NVIDIA GPU 中的 Tensor Core 或早期 TPU 的 MXU）在处理这类非连续内存访问时效率往往会下降。

Ironwood 芯片内部集成了第三代 Sparse Core（稀疏核心），该核心是一个独立于主张量处理单元（Tensor Core）之外的可编程数据流引擎，专门负责处理嵌入（Embedding）查找、Scatter-Gather（分散-收集）操作以及 MoE 模型中的专家路由（Routing）。在 Gemini 3 Pro 运行复杂的逻辑推理任务时，Sparse Core 能够以极低的延迟在芯片的片上高带宽内存（HBM）中快速索引并提取活跃专家的参数，而主张量核心则专注于执行高密度的矩阵乘法。

图 4：Ironwood 架构图



数据来源：Google，金元证券研究所

这种异构架构使得 Ironwood 在处理 Gemini 3 Pro 的非结构化的稀疏激活模式时，算力利用率比上一代提升了 40%以上，解决了大模型推理中 decoding 阶段面临的频繁内存访问问题。

其次，在支撑 Gemini 3 Pro 超大规模训练互连层面，谷歌将其独有的光路交换（Optical Circuit Switching, OCS）技术落地。Gemini 3 Pro 的训练集群并非传统的电缆连接，而是一个基于光的动态网络。在 Ironwood 超级计算集群（SuperPod）中，多达 9216 颗 TPU 芯片被封装在一个单一的逻辑计算域内。为了实现线性扩展，谷歌部署了名为 Project Apollo 的升级版 OCS 系统。

与传统的电交换机需要将光信号转换为电信号再进行路由不同，OCS 利用 MEMS 反射镜阵列，直接在物理空间中通过反射光束来改变连接拓扑。对于 Gemini 3 Pro 这样需要数月训练的模型，网络拓扑的需求在不同阶段是变化的。在进行数据并行训练时，需要高带宽的环状拓扑。而在进行流水线并行或专家并行时，则需要复杂的全互联拓扑。OCS 允许系统在毫秒级时间内通过旋转微镜片重构整个数据中心的网络布线，动态调整为流量最大的节点分配更多带宽。这种软件定义物理网络（SDN）的能力，使得 Gemini 3 Pro 的训练通信效率接近理论物理极限，同时极大地提高了容错能力，一旦某机柜芯片发生故障，光路可以瞬间绕过故障点，无需中断整个训练任务。

再者，内存子系统的更新是 Gemini 3 Pro 能够支持千万级 token 上下文窗口（Context Window）的关键。Gemini 3 Pro 的亮点是其全库级的信息检索与推理能力，这对显存容量和带宽提出了极高要求。Ironwood TPU 引入了近内存计算（Near-Memory Compute）的设计理念，并集成了最新的 HBM4 内存堆栈。每颗 Ironwood 芯片配备了高达 192GB 的 HBM4 内存，且单芯片内存带宽突破了 7.2 TB/s。

另外，谷歌在 Pod 级别引入了全局共享内存地址空间（Global Shared Memory）。通过特制的 ICI（Inter-Chip Interconnect）互联协议，一个机架内的 64 颗 TPU 可以无缝访问彼此的 HBM 内存，形成一块巨大的统一显存。这对于 Gemini 3 Pro 的长文本推理至关重要，当用户输入一本即时生成的数十万字技术手册并要求模型进行跨章节推理时，模型需要将海量的 KV Cache（键值缓存）驻留在显存中。Ironwood 的内存架构允许这些 KV Cache 分散存储在整个机架的内存池中，并通过超低延迟的光互联进行访问，从而实现了实际上“无限”的推理上下文，而不会因为单卡显存溢出导致性能崩溃。

我们认为，Gemini 3.0 Pro 并不是简单的参数量升级，而是围绕高性能推理+多模态应用展开的一次系统性范式跃迁。在模型层面，基于稀疏 MoE 架构、自动模型选择与 Deep Think 增强推理，实现了在长上下文、多模态理解与复杂推理任务上的 SOTA 表现，并显著优化性能/成本比；在系统与算力层面，则依托 TPU v6/v7（Ironwood）上的第三代 Sparse Core、OCS 光路交换网络以及 HBM4 与全局共享显存架构，解决了大模型在稀疏激活、超大规模训练与“无限上下文”推理中的算力利用率与内存瓶颈问题。综合来看，Gemini 3.0 Pro 代表的是从“训练优先、单一模态”向“推理优先、全模态、长上下文”的基础设施升级，与此同时，硬件需求或转向从强调通用计算的 GPU 至推理及应用的 ASIC 市场，集群连接则进一步强调全光方案。

相关公司：

- 1、ASIC 及推理芯片：寒武纪-U、瑞芯微、云天励飞等
- 2、OCS 及组件：光库科技、三环集团、赛微电子等

风险提示：

1、AI 需求不及预期：

AI 基础设施投入较大，需求落地不及预期，导致资产回报率较低

2、产业竞争格局风险：

随着以 Google、ChatGPT 为首的 AI 大模型占据市场，或导致市场份额逐渐集中

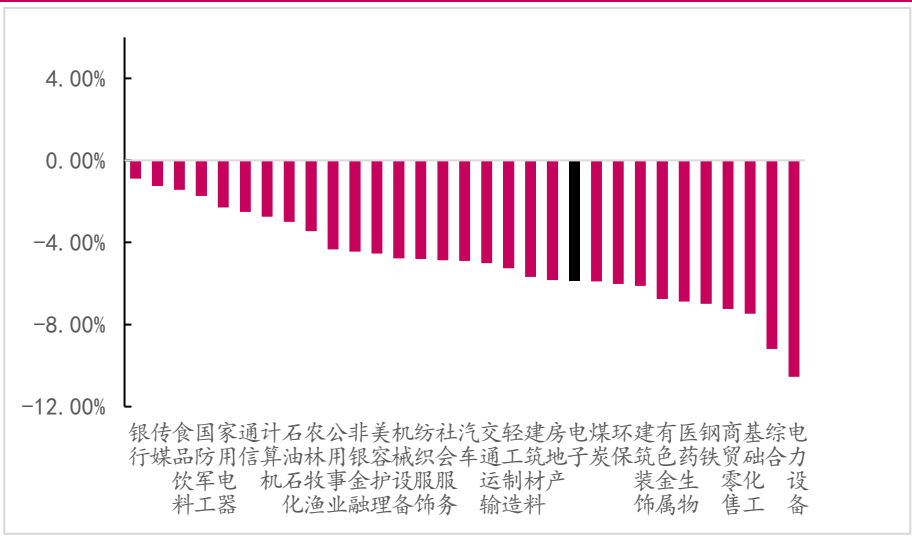
3、技术风险：

当前 AI 硬件、架构更新迭代频繁，或导致相关领域替代风险

二、行业跟踪

全行业：本周（2025. 11. 17-2025. 11. 21）上证指数下跌 3.90%，深证成指下跌 5.13%，沪深 300 指数下跌 3.77%，申万电子版块下降 5.89%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 21/31。板块个股涨幅前五名分别为：腾景科技、赛微电子、久之洋、大为股份、爱克股份；跌幅前五名分别为：香农芯创、显盈科技、阿石创、普冉股份、佰维存储。

图 5：本周各行业版块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
688195.SH	腾景科技	34.50	152.00	117.87	166.83	62.62	81.00	117.62
300456.SZ	赛微电子	28.71	33.49	26.18	34.99	78.39	468.31	141.26
300516.SZ	久之洋	23.60	48.60	38.75	50.44	29.58	53.25	23.98
002213.SZ	大为股份	16.87	32.98	27.34	36.64	140.28	289.96	92.43
300889.SZ	爱克股份	14.16	25.80	22.50	25.87	16.10	23.56	5.87

数据来源：Choice，金元证券研究所

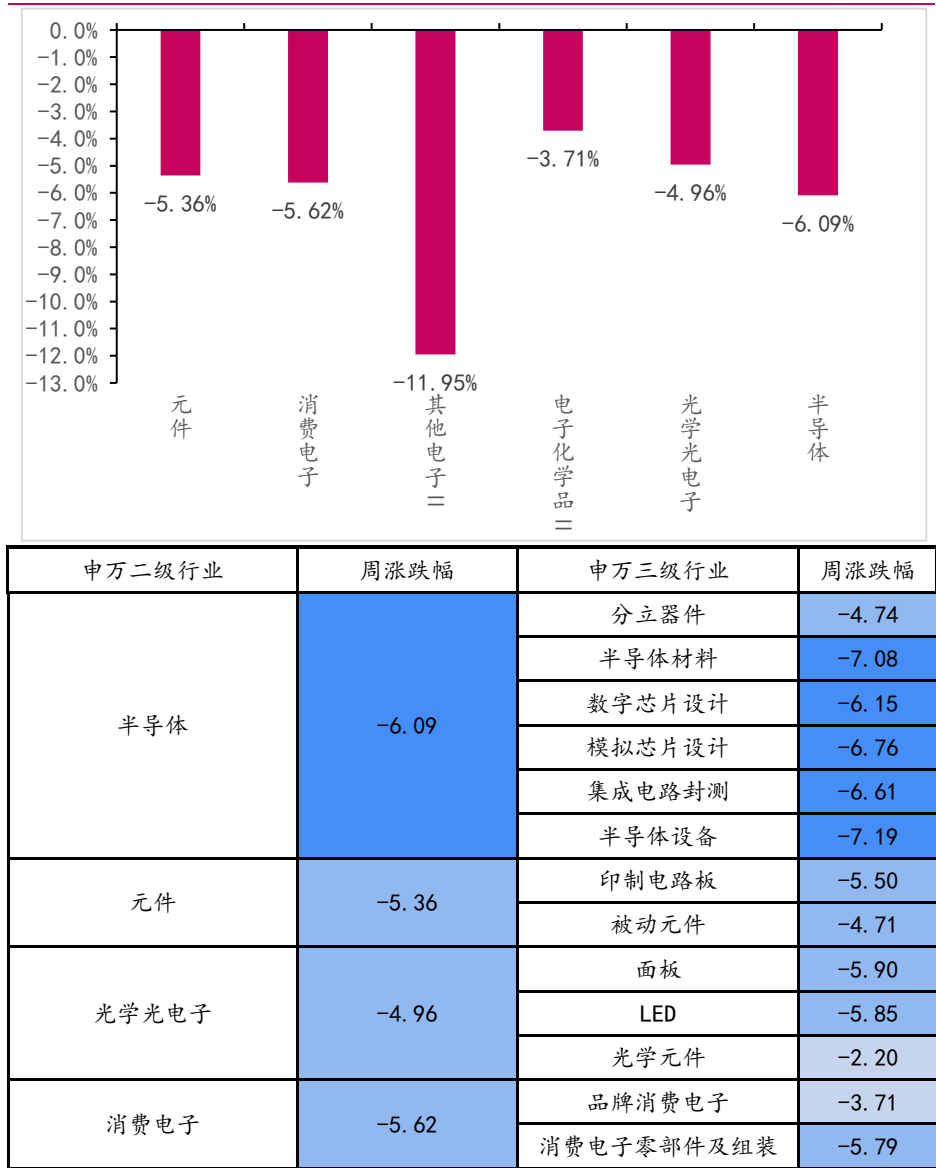
表 2：本周电子版块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
300475.SZ	香农芯创	-27.60	126.41	123.43	182.30	58.99	262.74	401.86
301067.SZ	显盈科技	-23.08	34.40	33.90	44.75	39.65	25.31	9.94
300706.SZ	阿石创	-20.96	33.00	32.98	43.00	52.96	60.15	23.56
688766.SH	普冉股份	-18.69	121.97	120.00	167.20	41.75	61.81	90.10
688525.SH	佰维存储	-18.43	103.66	100.01	142.99	46.77	165.01	198.65

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025.11.17 - 2025.11.21）电子行业呈现普跌且跌幅分化显著的格局。从申万二级行业数据看，各子板块均录得下跌，其中其他电子Ⅱ板块本周下跌11.95%，为本周表现最弱的方向；其下申万三级行业其他电子Ⅲ同样下跌11.95%，走势完全一致。半导体板块整体下跌6.09%，内部结构差异较大，半导体设备子板块下跌7.19%，模拟芯片设计下跌6.76%，半导体材料下跌7.08%，多个细分领域拖累板块表现。消费电子板块下跌5.62%，延续调整态势，消费电子零部件及组装下跌5.79%对板块形成主要拖累，品牌消费电子下跌3.71%。元件板块下跌5.36%，细分领域中印制电路板下跌5.50%，被动元件下跌4.71%，表现承压。光学光电子板块下跌4.96%，LED下跌5.85%，面板下跌5.90%，光学元件下跌2.20%，板块整体显弱势。电子化学品Ⅱ板块下跌3.71%，电子化学品Ⅲ子板块同幅下跌3.71%。总体来看，本周电子行业全板块下跌且分化明显，其他电子Ⅱ领跌，半导体、消费电子、元件等多个细分领域承压，行业呈现整体性调整且内部跌幅差异较大的态势。

图 6：本周电子版块：子版块涨跌幅



电子化学品	-3.71	电子化学品Ⅲ	-3.71
其他电子	-11.95	其他电子Ⅲ	-11.95

数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 7: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 8: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

三星将记忆体价格涨幅提高至六成，大型AI资料库建设压力增加

11月17日据《科技新报》报道，由于全球AI资料库大量兴建导致对记忆体需求大增，记忆体晶片供应出现短缺现象，三星电子昨日宣布部分记忆体晶片价格将调涨六成，预期将使资料库建设压力再度增加。《路透社》引述两名内部消息来源表示，继三星电子在十月期间暂缓公布价格讯息后，昨日正式发表了涨价消息。记忆体价格调涨除了将影响目前大量兴建中的AI资料库之外，手机、平板、笔电和PC等相关产品价格预计也将随之提高。

DARPA和德州政府斥14亿美元，打造3D异质整合实验晶圆厂

11月17日据《科技新报》报道，美国国防高等研究计划署与德州斥资14亿美元，打造一座独特的晶圆厂。这座晶圆厂是从德州电子研究所进行翻修，将负责研究3D异质整合、堆叠和组合等多种材料和晶片类型，以提升美国在军事、国防、AI和高性能运算的能力。这座晶圆厂是DARPA次世代微电子制造计划的基础设施。该计划的执行董事Michael Holmes表示，次世代微电子制造计划的核心就是透过3D异质整合，带来微电子革命。德州政府将投入5.52亿美元建立这座晶圆厂及其计划，DARPA则补足剩下的8.4亿美元。次世代微电子制造计划五年任务完成后，这座晶圆厂预计将能自行营运、成为一门可自给自足的生意。

记忆体价格大乱，传模组厂新品从今年Q4延后至2026年上市

11月17日据《科技新报》报道，近期记忆体价格因市场压力暴涨，主要原因在于AI基础建设带来的庞大记忆体需求。根据外媒Hardwareluxx报导，记忆体模组制造商将新记忆体套装，从原订的2025年下半年延后至2026年，希望观察供应紧缩对记忆体价格的影响。该报导指出，包括Corsair、十铨等品牌热门记忆体套装的大幅涨价，多家模组厂商表示，不会在今年第三、第四季推出原本计划的新套装。这些厂商选择观望2026年的记忆体价格走势，但未透露哪些具体产品被延后。先前市场消息传出，记忆体制造商没有增加DRAM产量的计划，代表短缺将延续到明年，甚至可能一路到2027年。如果情况不变，有专家认为，这场价格风暴将持续十年。

DDR4、DDR5报价全涨，华硕拟适度调价、佳世达成本移转

11月17日据《科技新报》报道，全球记忆体短缺问题日益严峻，如Corsair、威刚等制造商因价格激增而出现暂停接单的状况，这波涨势也逐渐波及华硕等PC制造商，对消费大众带来直接冲击。华硕共同执行长胡书宾日前在法说会中坦言，若供需失衡持续，将在适度状况下调整产品售价。佳世达集团董事长陈其宏透露，近来DDR4、DDR5成本几乎暴涨，直言DDR4市场正在经历很可怕的一波缺货潮，且短缺恐一路延续至2026年整年。他也坦言，DDR4持续上涨的价格得却也让企业吃不消，对成本造成了一定的压力。佳世达网路通讯事业群总经理黄文芳则表示，目前对于记忆体的零件，在价格上均公开透明，针对重要涨价情况，公司正持续与客户妥善协商，进行成本的移转。

特斯拉工程师出走潮扩大，马斯克转向AI梦想代价太高

11月17日据《科技新报》报道，特斯拉的工程师流失潮正值公司核心电动车使命的转变之际，最近，随着股东支持马斯克基于未来十年达成特定业绩目标的薪酬计划高达1兆美元，特斯拉的多位高层工程师相继离职。这一系列的离职事件反映出马斯克对特斯拉业务的重组，将重心转向尚未产生收入的人工智能驱动业务，如无人计程车和人形机器人，而非专注于电动车的销售。随着特斯拉的电动车销售在今年下降约6%，尽管第三季的交付量因美国消费者在税收抵免结束前的抢购而激增，但缺乏新产品的推出使得公司未来几季的销售前景不容乐观。随着高层工程师的离职，特斯拉的管理层问题愈发凸显，缺乏强有力的执行团队和明确的接班计划。专家警告，马斯克若有变动可能会导致特斯拉的估值崩溃，这一风险不容小觑。

台积电CoWoS不再唯一，苹果、高通评估Intel先进封装作为替代

11月18日据《科技新报》报道，全球对先进封装的需求持续升温，市场对台积电CoWoS产能的依赖也推向高峰。近期外电报导，苹果与高通在新的职缺要求中，明确列出英特尔的EMIB与Foveros等封装技术经验，显示多家大厂正寻求CoWoS以外的替代方案，以因应AI与HPC晶片需求快速成长下的产能瓶颈。英特尔执行长暨高层多次强调，Foveros与EMIB已取得多家客户的兴趣，并具备量产能力。与英特尔的Foveros与EMIB相比，CoWoS成熟度高、产能规模最大，并拥有广泛的HPC/GPU客户，因此仍是市场主流。市场人士指出，虽然CoWoS仍占据先进封装主导地位，但随着AI、资料中心与客制化晶片需求加速攀升，各大晶片公司都在寻找新的供应链组合。苹果与高通此次在职缺上明确点名Intel技术，被视为产业开始多元布局的讯号，也意味着未来先进封装供应链将从单一依赖CoWoS，逐渐走向双供应模式的可能。

台积电全球布局，两年获政府补助1,470亿元

11月18日据《科技新报》报道，台积电前进美国、日本、德国及中国投资设厂，第三季获得政府补助新台币47.7亿元，累计前三季获718.98亿元政府补助，近两年共获得1,470亿元补助。台积电子公司TSMC Arizona、ESMC、JASM及台积电南京等，因于美国、德国、日本及中国设厂营运，取得当地政府补助款，主要用于补贴不动产、厂房及设备购置成本，以及建造厂房与生产营运所产生的部分成本与费用。台积电继今年上半年取得671.28亿元政府补助后，第三季再获得47.7亿元补助，今年前三季累计获得718.98亿元补助；加计去年取得751.64亿元补助，台积电近两年共累计获得1,470亿元补助。

三星2奈米抢下中企挖矿订单，低价抢攻台积电市场

11月18日据《科技新报》报道，中国两家挖矿设备制造商已决定采用三星电子的2奈米GAA制程，用于下一代高效能晶片开发。法人指出，三星在先进制程上采取更具弹性的价格策略，对讲求大量采购与单位成本优化的挖矿业者具吸引力。虽然技术表现与长期良率仍需市场验证，但价格因素确实可能促使部分客户评估替代性供应来源，特别是在币价波动、营运成本压力加剧的周期中。目前，三星透过2奈米GAA制程持续推动客户多元化，包括手机、伺服器、汽车及加密货币挖矿等应用领域都有布局，有助改善先进制程长期亏损的压力。然而在高效能晶片市场，良率与制程信赖度依然是客户最重视的核心因

素。尽管新客户进场有助三星逐步建立生态系，但在关键大客户仍集中于台积电的前提下，全球先进制程格局短期内仍维持现状。

超级电脑Perlmutter用110亿网格模拟量子晶片，制造前就能预见未来

11月18日据《科技新报》报道，11月14日，劳伦斯柏克莱国家实验室的量子系统加速器研究人员Zhi Jackie Yao和Andy Nonaka，利用其超级电脑Perlmutter进行一项前所未有的量子晶片模拟。这个模拟不仅帮助研究人员在晶片制造之前理解其功能和性能，还能及早发现潜在问题。这项研究的关键在于开发电磁模型，以模拟量子晶片的行爲，这是提升量子硬体性能的重要步骤。Nonaka表示，我们的计算模型预测设计决策如何影响晶片中的电磁波传播，以确保信号耦合正确并避免不必要的串扰。这次模拟的独特之处在于其细致的计算能力，研究团队几乎使用了Perlmutter的所有7168个辉达GPU，并在24小时内捕捉到一个仅10平方毫米、厚0.3毫米的多层晶片的结构和功能。Nonaka指出，我们将晶片离散化为110亿个网格单元，并在七小时内运行超过一百万个时间步骤，这使我们能在一天内评估三个电路配置。

英特尔Granite Rapids-WS曝光，Intel 3制程、最高128核登场

11月18日据《科技新报》报道，知名爆料者momomo_us近日曝光了Granite Rapids-WS的完整产品线SKU名单，显示Intel正加速布局高阶工作站市场。根据其贴文与后续回复，Granite Rapids-WS系列预计将推出至少11款型号。Granite Rapids-WS采用Intel 3制程并搭配全新W980平台。Intel 3作为Intel迈向GAA之前的末代FinFET节点，效能约当等同台积电5奈米，是推动高时脉与高密度核心布局的重要基础。在架构层面，Granite Rapids-WS延续Granite Rapids伺服器平台的模组化方向，但快取配置较为保守，以换取更好的功耗与成本平衡。三晶粒设计让Intel在需要时可扩展至128核，在仅采用两颗compute tiles时则可形成更具成本效益的多核心SKU。先前报导亦曾提到一款具备86核、172执行绪的工程晶片，其设计推测对应Granite Rapids-WS的高阶型号，并与momomo_us所揭露的SKU列表相符。若Intel最终推出128核的旗舰型号，将使其在核心数上首次逼近甚至可能超越AMD Threadripper 9995WX的96核Zen 5配置。

安谋携手辉达NVLink，抢攻AI伺服器CPU市场

11月19日据《科技新报》报道，英国半导体设计大厂安谋今天表示，以其技术打造的中央处理器，未来将可与人工智慧晶片巨擘辉达的NVLink Fusion技术相互整合。财经媒体CNBC报导，此举将使两家公司客户、尤其是那些偏好客制化基础设施的超大规模资料中心业者，更容易将Arm架构的Neoverse CPU与辉达的绘图处理器搭配使用。这是辉达透过合作，几乎将所有大型科技公司纳入其AI生态系的最新一例，也显示辉达正在逐步开放其NVLink平台，使其能与更多客制化晶片整合，而非要求客户只能使用辉达自家的CPU。

三星以Exynos 2600压价应付成本，重整旗舰手机晶片布局

11月19日据《科技新报》报道，三星电子正调整旗舰智慧手机的行动处理器策略，重新提升自家晶片的采用比例。据韩媒报导，三星预计在明年Galaxy S26系列部分机型导入2奈米Exynos 2600，并比高通Snapdragon同级晶片低2

0~30美元的价格提供给内部MX事业部，借此降低持续上升的AP采购成本。根据三星季报，今年截至第三季，三星行动AP采购金额达10.9兆韩元，较去年同期增加25.5%。在旗舰手机高度仰赖高通晶片的情况下，成本负担逐年扩大，压缩整体毛利率。Exynos 2600以明显更低的价格回归旗舰系列，被视为三星重新掌握成本、增加采购议价能力的重要节点，Galaxy S26 的实际销售与使用回馈，将成为三星评估后续Exynos扩大采用与重新定位旗舰晶片布局的重要依据。

英特尔砍掉8通道Diamond Rapids，全面转向16通道伺服器平台

11月19日据《科技新报》报道，英特尔近期调整伺服器产品路线，原计划将于2026年推出的 Xeon 7系列确定取消8通道版本，平台将全面聚焦于16通道处理器，以因应资料中心对记忆体容量与频宽快速提升的需求。英特尔向外媒ServeTheHome证实，8通道Diamond Rapids已自产品蓝图中移除，并强调未来将简化平台设计，将16通道的效能优势向下延伸至不同客户应用场景。外电指出，16通道Diamond Rapids可望支援高达12800MT/s的记忆体速度，最大记忆体频宽上看1.6TB/s，有助提升AI与高效能运算环境的资料存取效率。

美国制造代价高昂，台积电美厂获利大缩水、先进制程成唯一突破口

11月19日据《科技新报》报道，台积电第三季财报显示，美国子公司单季仅赚约新台币4千万元，与上季的42.32亿元相比几乎呈现跳水式收缩，凸显美国建厂初期庞大成本正快速侵蚀获利。法人指出，美国基地真正的关键并不在眼前的获利数字，而是在于3奈米、2奈米等先进制程是否能顺利落地并拉升产能利用率。台积电目前规划于2027年启动美国3奈米量产，同时针对包含GA A与Backside Power在内的2奈米技术进行可行性评估。一旦先进节点成功导入，美国厂将能在全球先进制程战略布局中扮演更具重量的角色。随着先进封装需求升高，美国在地供应链不足的情况也愈加明显。多家台系材料与设备厂已因应台积电的扩建进度陆续投入美国专案。业者表示，美国封测作业的成本结构更高、交期压力也更大，因此能否稳定取得台系供应链的支援，将直接左右美国基地未来先进封装的扩张速度。

传台积电前资深副总罗唯仁带走先进制程资料，经部派员了解

11月19日据《科技新报》报道，台积电前技术研发暨企业策略发展资深副总经理罗唯仁，退休前疑似利用职权带走2奈米等先进制程影印资料，并传出回锅英特尔。经济部长龚明鑫今天受访表示，已派员了解实际状况。媒体报导，75岁的罗唯仁7月底自台积电退休，但退休前动用本身高阶主管职权，要求下属简报，并影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先进制程技术相关机密资料带走，台积电搜证中，准备对他有所动作。业界也传出罗唯仁已于10月底赴老家英特尔任职。龚明鑫下午出席活动受访表示，今早已请员工了解实际状况，但实际状况还是要由公司（台积电）对外说明较好，也算是尊重他们。

记忆体短缺恶化，AMD、辉达传缩减游戏显卡产能

11月20日据《科技新报》报道，全球记忆体供应链正面临新一轮急剧紧缩。根据韩媒报导，受GDDR显示记忆体成本大幅上涨影响，AMD与辉达传出可能缩减甚至暂停部分GPU的生产，以将有限的记忆体优先分配至毛利较高的产品线。

虽然报导未点名具体型号，但市场普遍推估，面向大众市场的60系列与50系列恐将首当其冲。供应链人士指出，在记忆体全面吃紧的情况下，消费型GPU的供货势必受到影响。记忆体价格快速飙升，是推动此次事件的主因。摩根士丹利指出，过去六个月NAND现货价格上涨约50%，DRAM现货更暴涨300%，涨势远高于2016~2018年记忆体长周期的涨幅。通路资料也显示，自7月以来，桌机用DDR4、DDR5、SSD主流容量售价普遍上涨50%~70%，部分高阶DDR5模组更累计上涨80~130%。外电分析，RAM的急涨已开始推升GPU BOM成本，预料也会反映在未来显卡售价之上。

美国或将允许晶片出口沙国AI新创Huma in

11月20日据《科技新报》报道，彭博社引述知情人士的话透露，美国计划批准首次向沙乌地阿拉伯的AI公司Huma in出售先进人工智慧晶片。值得注意的是，这个时间正逢沙乌地阿拉伯王储Mohammed bin Salman赴白宫与美国总统川普见面，承诺在美投资高达1兆美元的时候。这些批准预计将作为美国与沙乌地阿拉伯之间更广泛AI协议的一部分。该协议最快可能本周完成。而自2023年起，沙乌地阿拉伯一直需要美方许可才能进口这类晶片。据悉，这次会面还包括了雪佛龙、高通、辉瑞等企业执行长。这项双边协议不仅帮助Huma in获得晶片出口许可，也有利于在沙国设有专案的美国公司。

马斯克亲揭想自制晶片原因、称台积电、三星不够快

11月20日据《科技新报》报道，全球首富马斯克直指，特斯拉未来每年也许需要1000~2000亿的AI晶片，台积电、三星电子赶制的速度不够快。Tom's Hardware 18日报导，马斯克14日接受Baron Capital创办人兼执行长Ron Baron访问时指出，我对台积电、三星怀有极大敬意，我们在特斯拉、SpaceX跟台积电与三星协力合作。他们是很棒的公司，我们希望他们能尽快为我们制造晶片，并把产能扩充到他们觉得可以的产量。但这似乎不够快。马斯克表示，当我询问从头建造一座全新晶圆厂要花多久时间时，他们回答说要五年才能投产。五年对我来说就等于永恒。我的时间线是一年、两年，我甚至无法看到三年后。这个速度不够快。若他们改变心意，说可以快一些，每年供应我们需要的1000亿至2000亿AI晶片，那就太棒了。

安世事件影响汽车业，博世数千人面临停工

11月20日据《科技新报》报道，安世半导体贸易争端引发的晶片供应短缺，仍是德国汽车业大挑战。博世18日表示，已有数千工人面临停工。博世表示，位于德国安斯巴赫、萨士吉特及葡萄牙境内的布拉加三大中心，生产作业面临中断。总部位于荷兰的安世半导体，晶片技术简单，却广泛用于汽车电子系统与其他消费产品。由于担心技术外流，荷兰政府9月接管这家公司，促使中国限制公司成品出口，使博世、欧摩威和采埃孚等主要供应商不得不寻找替代方案，中国商务部对部分供应商也予以出口禁令豁免。由于供应短缺减缓生产，博世已在必要时让工人回家。发言人表示，目前正依需要，对萨士吉特300~400名员工、安斯巴赫约650名员工采取临时停工措施。发言人补充，布拉加工厂3300名员工，约2500人受临时工时调整，或留职停薪影响。

AI冲击、签证收紧、企业限缩工作弹性，数位游牧黄金时代或走向终章

11月20日据《科技新报》报道，2020年疫情后，远距工作与数位游牧一度成为理想生活的代名词，许多人一边打工一边环游世界。然而短短四年后，这场自由工作的浪潮正逐渐退潮，人工智慧、签证政策与企业文化的多重变化，正在改写这场全球自由人运动。外媒QUARTZ报导，34岁的安东尼曾靠旅游网站撰稿维生，但随着Google搜寻演算法更新、AI自动生成内容崛起，她的工作消失了。她不断听到企业说我们不再聘请撰稿人，只用AI，数位内容经济受到冲击，小型网站流量暴跌，许多自由接案者陷入困境。还有那些曾因疫情开放游牧签证的国家也开始设限。葡萄牙、西班牙等地调整税制与居留条件，要求外籍工作者正式注册并缴税。国际劳动市场的自由流动性，正被重新定义。

辉达续与鸿海纬创艾克尔矽品合作，四年内扩大美国布局

11月21日据《科技新报》报道，人工智慧晶片大厂辉达今天清晨举行线上法人投资会议，辉达财务长克瑞斯指出，辉达会持续与鸿海、纬创、艾克尔、矽品精密及其他伙伴合作，未来4年扩大辉达在美国布局。谈到与供应链合作进展，辉达执行长黄仁勋回答法人提问表示，包括台积电晶圆制造和先进封装、记忆体供应商、以及所有系统原厂设计制造厂商，均呈现良好的工作成果。她表示，辉达和台积电在10月已携手在台积电美国亚利桑那州厂，生产出第一片美国本土制造的辉达Blackwell晶圆产品。克瑞斯指出，辉达会持续与鸿海、纬创、封测大厂艾克尔、日月光投控旗下矽品精密、以及其他供应链伙伴，在未来4年扩大辉达在美国的布局。

黄仁勋平息AI泡沫疑虑，三平台同时转型、基建夯

11月21日据《科技新报》报道，辉达执行长黄仁勋强调，AI不是泡沫，目前全世界正在同时经历三大平台转型，是未来几年AI基础建设投资的根基。据卫报、Investing.com报导，黄仁勋19日在财报电话会议表示，全世界正在同时经历三大平台转型，是自摩尔定律诞生以来首次发生的现象，而辉达可以提供独到的解方。黄仁勋表示，第一个平台转型是从CPU通用运算转型至GPU加速运算。第二个平台转型是生成式AI开始取代传统机器学习。第三个平台转型是代理式AI与实体AI的崛起。他表示，辉达之所以雀屏中选，是因为我们的单一架构能够协助实现以上三种转型，也能因此支援所有产业各种形式的AI、涵盖AI的每一阶段，满足云端多样的运算需求，并从云端延伸至企业与机器人。

放行中东采购，美允许G42、Humain各自可获3.5万颗AI晶片

11月21日据《科技新报》报道，美国已批准向阿联酋AI公司G42以及沙乌地阿拉伯AI新创Humain出售数万颗先进AI半导体。根据美国商务部的说法，两家公司各自获准取得3.5万颗NVIDIA GB300或同级产品的AI晶片。交易前提是两家公司必须遵守严格的安全与通报要求。知情人士透露，美国和这两国针对与中国相关的风险进行协商，协议内容包括防止敏感技术流向外国敌对势力等条款。先前阿联酋G42已承诺将与华为进行业务切割，并进一步与微软达成15亿美元合作；沙国的Humain也公开承诺不采购华为设备。目前不清楚美国针对两间公司出口许可的附带安全条件。然而，川普政府部分官员仍对此表达担忧，认为这些高性能运算设备或AI系统可能有利于中国军方。

硕童子贤表示记忆体涨价与代工厂获利无关

11月21日据《科技新报》报道，记忆体价格近期飙涨，美系外资报告示警硬体供应链获利恐受影响，点名和硕等五家台厂。代工厂和硕董事长童子贤今天表示，外资报告判断有一点奇特，通常品牌商会负责零组件调度，代工厂只是代支代付，关键零组件价格涨跌其实与代工厂无关。外界关注记忆体涨价后代工厂是否会亏损，童子贤明确表示不会，因为品牌商都希望掌握关键决策，会自己负责调度关键零组件并谈判好，代工厂做的只是程序代支代付，先帮品牌商代垫货款，最后品牌商再付给代工厂，所以关键零组件的价格涨跌，其实与代工厂无关。

马斯克预言 AI 将让钱变得不重要，工作变成玩游戏

11月21日据《科技新报》报道，亿万富翁马斯克17日在美国—沙乌地阿拉伯投资论坛预测，随着人工智慧和机器人技术的进步，未来货币将变得不再重要。马斯克在论坛上与辉达首席执行官黄仁勋共同参加了一个小组讨论，并表示，尽管仍然会有电力和质量等基本物理限制，但货币的相关性将随着时间的推移而减少。在过去几个月中，马斯克不断分享他对AI未来的愿景，包括消除贫困的想法。他在最近一次股东会议上表示，实现这个目标的唯一方法是透过Optimus机器人。马斯克还提到，当AI和机器人技术消除了所有工作和货币时，政府应该提供普遍的高收入，而不仅是基本收入。他强调，这样的收入将使每个人都能获得所需的产品和服务，但在此过程中将会面临许多创伤和动荡。

四、公司公告

洲明科技：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告

公司于11月17日发布公告，深圳市洲明科技股份有限公司披露公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林洺锋先生拟通过大宗交易方式减持所持本公司股份。根据公告，截至本公告披露日，林洺锋先生持有公司股份268,973,418股，占公司总股本的比例为24.65%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为24.77%。本次计划的减持时间区间自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月9日至2026年3月8日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外，且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司扣除已回购股份后总股本的2%；拟减持股份数量不超过21,722,009股，减持比例不超过公司总股本的1.99%，不超过公司扣除已回购股份后总股本的2.00%。公司表示，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促控股股东、实际控制人按照相关规定进行股份减持并及时披露信息。

豪威集团：2025年中期权益分派实施公告

公司于11月18日发布公告，拟实施2025年中期权益分派：以总股本1,209,404,099股扣除回购专户已回购3,921,163股后的1,205,482,936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利482,193,174.40元，不进行送股或转增分配；股权登记日为2025年11月

21日，除权除息日为2025年11月24日，沪港通及境外机构等适用10%预提税，个人投资者按持股期限差异化征税；A股现金红利由中国结算上海分公司代派，公司股东虞仁荣先生、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贾渊先生、纪刚先生的现金红利由公司自派，公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。本次利润分配方案已经公司2025年6月10日股东大会授权并经公司2025年10月28日董事会审议通过。

成都华微：股东减持股份计划公告

公司于11月18日发布公告，成都华微电子科技有限公司披露股东成都华微电子科技有限公司（有限合伙）、成都华微展飞伙伴企业管理中心（有限合伙）、成都华微同创共享企业管理中心（有限合伙）及成都华微共融众创企业管理中心（有限合伙）拟通过集中竞价或大宗交易方式实施的股份减持计划。公告显示，截至本公告披露日，华微众志持有公司股份 48,776,536 股，占公司总股本的 7.6591%；华微展飞持有公司股份 15,635,708 股，占公司总股本的 2.4552%；华微同创持有公司股份 12,850,171 股，占公司总股本的 2.0178%；华微共融持有公司股份 9,974,703 股，占公司总股本的 1.5663%。根据公告，华微众志拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内合计减持股份不超过 6,172,005 股；华微展飞、华微同创、华微共融自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内分别合计减持股份不超过 4,130,308 股、4,126,762 股、3,769,031 股。公司表示，本次减持计划符合相关法律法规要求，不会对公司治理、经营管理及控制权结构产生不利影响。公司股东将严格按照法律法规、相关监管及相应承诺的要求实施减持，并及时履行信息告知义务，同时公司将及时履行信息披露义务。

普冉股份：关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司股权的公告

公司于11月18日发布公告，普冉半导体(上海)股份有限公司披露收购珠海诺亚长天存储技术有限公司31%股权。根据公告，2025年11月17日，公司与珠海诺亚长天存储技术有限公司现有股东珠海诺延、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，拟收购诺亚长天31%股权，转让价格合计人民币14,364.01万元，公司将以现金支付方式完成本次交易，资金来源为自有和自筹资金。本次交易完成后，公司对标的公司的持股比例将达到51%，实现对标的公司的控股，从而间接控股SkyHigh Memory Limited。公司表示，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司提示本次交易可能存在公司与目标公司整合效果和协同效应不达预期、行业经营波动等风险，公司将根据本次交易的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

力源信息：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告

公司于11月18日发布公告，武汉力源信息技术股份有限公司披露将以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本。根据公告，本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，公司拟使用股票回购专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,000万元，不超过3,000万

元，回购价格不超过15.00元/股（含）。若全额回购且按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计本次可回购股份数量为2,000,000股，占公司目前总股本的0.17%；若全额回购且按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为1,333,333股，占公司目前总股本的0.12%。本次回购方案经公司2025年10月28日董事会和2025年11月14日临时股东会审议通过。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

慧智微：股东减持股份计划公告

公司于11月18日发布公告，广州慧智微电子股份有限公司披露股东GZPA Holding Limited拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份。根据公告，截至本公告披露日，GZPA持有公司股份10,521,604股，持股比例2.25%，均来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于2024年5月16日解除限售并上市流通。自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内，GZPA拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份，合计减持不超过10,521,604股，合计减持比例不超过公司股份总数的2.25%。公司表示，本次减持计划不会对公司治理、经营管理及控制权结构产生不利影响，相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。

万润科技：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

公司于11月18日发布公告，深圳万润科技股份有限公司披露拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损。根据公告，《关于使用公积金弥补亏损的议案》经公司2025年10月30日董事会和2025年11月17日股东会审议通过。公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积31,885,487.09元，使用资本公积1,095,933,802.28元，合计1,127,819,289.37元，以期未分配利润负数弥补至零为限。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

晶瑞电材：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告

公司于11月18日发布公告，晶瑞电子材料股份有限公司披露部分董事及高级管理人员的股份减持计划。公司董事长李勃先生持有公司0.0649%股份，拟通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持数量不超过174,000股，占公司总股本0.0162%；公司董事兼总经理胡建康先生持有公司0.1363%股份拟通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持数量不超过365,000股，占公司总股本0.0340%；公司财务总监顾友楼先生持有本公司0.0065%股份，拟通过集中竞价方式减持数量不超过17,000股，占公司总股本0.0016%。本次计划的减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2025年12月9日至2026年3月8日。公司表示，本次减持计划符合法律法规及相关规定的要求，计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

银河微电：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告

公司于11月19日发布公告，常州银河世纪微电子股份有限公司披露公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。根据公告，本次限制性股票激励计划授予日为2024 年 9 月 20 日；归属数量为63.85 万股；授予价格（调整后）为14.77 元/股；归属人数为82名；股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。公司表示，本次归属条件已经成就符合法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将按照相关法规履行后续信息披露义务。

好利科技：2025年第五次临时股东会决议公告

公司于11月19日发布公告，好利来（中国）电子科技股份有限公司披露公司 2025 年第五次临时股东会决议。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场出席会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表股份 54,875,839 股，占公司有表决权股份总数的29.9917%；通过网络投票出席会议的股东共 75 人，代表股份 630,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3448%。本次股东会审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。公司表示，本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

灿瑞科技：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告

公司于11月19日发布公告，上海灿瑞科技股份有限公司披露公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就。根据公告，本次限制性股票授予日为2024年11月18日，第一个归属期为2025年11月18日至2026年11月17日；归属数量为73.6990万股；授予价格（调整后）为15.67元/股；归属人数70名；股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。公司表示，本次归属条件已经成就符合法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将按照相关法规履行后续信息披露义务。

华海清科：关于持股5%以上的股东减持股份计划公告

公司于11月20日发布公告，华海清科股份有限公司披露股东路新春先生拟通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份。截至本公告披露日，路新春先生持有公司股份 20,998,046 股，占公司总股本 5.94%，股份来源均为公司 IPO前取得的股份及通过资本公积转增股本取得的股份。根据公告，路新春先生拟于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日，减持合计数量不超过 3,534,051 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%。公司表示，本次减持计划符合有关法律法规的规定，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

福光股份：关于控股股东增持公司股份计划的公告

公司于11月20日发布公告，福建福光股份有限公司披露控股股东中融（福建）

投资有限公司拟自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份。根据公告，本次增持计划金额不低于8,000万元人民币，不超过15,000万元人民币，增持价格不低于21.00元（含）/股。资金来源为自有资金或自筹资金，中国光大银行福州分行已向中融投资出具《贷款承诺函》，同意为中融投资增持公司股票提供专项贷款，贷款额度不超过人民币13,500万元，期限3年。公司表示，本次增持计划符合法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

深圳华强：2025年第三季度权益分派实施公告

公司于11月20日发布公告，深圳华强实业股份有限公司拟实施2025年第三季度权益分派。根据公告，本次权益分派以总股本 1,045,909,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即分配现金股利总额为 209,181,864.40 元；股权登记日为2025年11月26日，除权除息日为2025年11月27日；A股现金红利由中国结算深圳分公司代派，公司股东深圳华强集团有限公司的现金红利由公司自派。本次利润分配方案经公司2025年11月13日股东会审议通过。

金禄电子：2025年前三季度权益分派实施公告

公司于11月20日发布公告，金禄电子科技股份有限公司拟实施2025年前三季度权益分派。根据公告，本次权益分派以总股本 151,139,968 股剔除已回购股份 1,655,200 股后的 149,484,768 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利 22,422,715.20元，不送红股、不使用资本公积金转增股本。股权登记日为2025年11月27日，除权除息日为2025年11月28日；A股现金红利由中国结算深圳分公司代派，公司股东李继林、麦睿明、叶庆忠、周敏以及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自派，公司通过回购专用账户持有的本公司股份1,655,200股不享有参与本次利润分配的权利。本次利润分配方案经公司2025年3月28日董事会和2025年4月22日股东会审议通过。

鑫汇科：关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告

公司于11月20日发布公告，深圳市鑫汇科股份有限公司披露公司拟由全资子公司鑫汇科电器收购控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司10.00%的股权。根据公告，公司控股孙公司心静电磁注册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科电器持股 90.00%，赵克芝持股 10.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 818.04 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 889.25 万元。本次收购拟由全资子公司鑫汇科电器以人民币 135.00 万元收购赵克芝所持有心静电磁 10.00%的股权，现金来源于公司的自有资金。本次股权收购完成后，鑫汇科电器持有心静电磁 100.00%的股权。公司表示，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，公司将完善各项内部控制制度，加强对外投资管理运营的监督和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

生益电子：关于股东减持股份计划公告

公司于11月21日发布公告，生益电子股份有限公司披露公司股东东莞科技创新投资集团有限公司拟通过集中竞价交易方式减持所持有本公司股份。截至本公告披露日，东莞科技创新投资集团直接持有公司股份8,404,110股，占公司总股本1.01%；东莞市国弘投资有限公司直接持有公司股份66,442,666股，占公司总股本7.99%；东莞科创投资集团和国弘投资为一致行动人，合计持有公司9.00%的股份。根据公告，东莞科创投资集团拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持其所直接持有的公司无限售条件流通股不超过8,318,211股，减持比例不超过公司总股本1.00%。公司表示，本次减持计划不会对公司控制权、治理结构及未来持续经营产生重大影响，减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

华亚智能：关于公司股东计划减持股票的预披露公告

公司于11月21日发布公告，苏州华亚智能科技股份有限公司披露公司股东崩海波、徐军、徐飞、刘世严拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有本公司股份。上述股东为一致行动人，合计持有公司股份9,124,748股，占公司总股本6.82%，是持有公司股份超过5%的股东，拟自减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内，即2025年12月15日至2026年3月14日，通过集中竞价减持1,312,275股，占公司总股本比例0.98%；通过大宗交易减持2,679,800股，占公司总股本比例2.00%；合计减持不超过3,992,075股，占公司总股本比例2.98%。公司表示，本次减持计划符合法律、法规及规范性文件的规定，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

拓荆科技：股东大宗交易减持股份计划公告

公司于11月21日发布公告，拓荆科技股份有限公司披露股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟通过大宗交易方式减持公司股份。截至公告披露日，国家集成电路基金持有公司股份55,026,693股，占公司总股本的19.57%，其所持股份全部为公司首次公开发行前股份，均为无限售流通股。根据公告，国家集成电路基金拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,434,917股，即不超过公司总股本的3%。公司表示，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司将持续关注股东减持计划实施情况，依照法律法规及时履行信息披露义务。

沪电股份：关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告

公司于11月21日发布公告，沪士电子股份有限公司披露公司将购买关联方Schweizer Electronic AG持有的胜伟策电子（江苏）有限公司股权。根据公告，公司拟以19,009,05欧元的价格购买关联方Schweizer持有的胜伟策15%股权，并同意胜伟策以1,990,950欧元的价格向Schweizer购买一组专利及技术资产，本次交易完成后，公司持有胜伟策的股权比例将由84%增加至99%。公司表示，本次关联交易不构成重大资产重组、不构成重组上市，

公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	第二十二届中国国际半导体博览会	11. 23-11. 25	北京市	中国半导体行业协会等
2	第六届亚太碳化硅及相关材料国际会议	11. 25-11. 27	郑州市	中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟等
3	2025 智能机械自动化及装备创新技术国际研讨会	11. 27-11. 29	宁波市	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	国光电器	股东大会举办	2025-11-28	
2	和而泰	股东大会举办	2025-11-28	
3	崇达技术	股东大会举办	2025-11-28	
4	ST 长方	股东大会举办	2025-11-28	
5	艾比森	股东大会举办	2025-11-28	
6	英飞特	股东大会举办	2025-11-28	
7	易天股份	股东大会举办	2025-11-28	
8	南极光	股东大会举办	2025-11-28	
9	奕东电子	股东大会举办	2025-11-28	
10	*ST 波导	股东大会举办	2025-11-28	
11	传音控股	股东大会举办	2025-11-28	
12	泰凌微	股东大会举办	2025-11-28	
13	风华高科	股东大会举办	2025-11-27	
14	航宇微	股东大会举办	2025-11-27	
15	容大感光	股东大会举办	2025-11-27	
16	安克创新	股东大会举办	2025-11-27	
17	爱克股份	股东大会举办	2025-11-27	
18	徕木股份	股东大会举办	2025-11-27	
19	寒武纪	股东大会举办	2025-11-27	
20	聚灿光电	股东大会举办	2025-11-26	
21	协创数据	股东大会举办	2025-11-26	
22	奥尼电子	股东大会举办	2025-11-26	
23	电科芯片	股东大会举办	2025-11-26	
24	超颖电子	股东大会举办	2025-11-26	
25	利通电子	股东大会举办	2025-11-26	
26	麦捷科技	股东大会举办	2025-11-25	
27	博敏电子	股东大会举办	2025-11-25	

28	安集科技	股东大会举办	2025-11-25
29	茂莱光学	股东大会举办	2025-11-25
30	芯海科技	股东大会举办	2025-11-25
31	康希通信	股东大会举办	2025-11-25
32	洲明科技	股东大会举办	2025-11-24
33	苏大维格	股东大会举办	2025-11-24
34	润欣科技	股东大会举办	2025-11-24
35	*ST 华微	股东大会举办	2025-11-24
36	方正科技	股东大会举办	2025-11-24
37	工业富联	股东大会举办	2025-11-24
38	永新光学	股东大会举办	2025-11-24
39	金宏气体	股东大会举办	2025-11-24

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
920212. BJ	智新电子	2025-11-24	33. 77	10, 610. 00	5, 126. 26	48. 32	5, 160. 04	48. 63	股权激励限售股份
688127. SH	蓝特光学	2025-11-24	256. 93	40, 589. 77	40, 332. 84	99. 37	40, 589. 77	100. 00	股权激励一般股份
688045. SH	必易微	2025-11-26	3, 214. 28	6, 983. 78	3, 769. 51	53. 98	6, 983. 78	100. 00	追加承诺限售股份 上市流通
688210. SH	统联精密	2025-11-26	46. 09	16, 185. 88	16, 139. 79	99. 72	16, 185. 88	100. 00	股权激励一般股份
688120. SH	华海清科	2025-11-26	24. 69	35, 365. 20	35, 340. 51	99. 93	35, 365. 20	100. 00	股权激励一般股份
688249. SH	晶合集成	2025-11-26	145. 65	200, 613. 52	118, 676. 17	59. 16	118, 821. 82	59. 23	股权激励一般股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。